

证券代码：301282

证券简称：金禄电子

金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的全体投资者
时 间	2026 年 8 月 18 日 15:00-17:00
地 点	价值在线平台（ https://www.ir-online.cn/ ）
形 式	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 李继林先生 独立董事 汤四新先生 独立董事 陈世荣先生 董事会秘书 陈 龙先生 财务总监 张双玲女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 8 月 18 日在价值在线平台采用网络远程的方式举行 2026 年半年度业绩说明会。在本次说明会上，公司在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答，具体情况如下： 1、新产能爬坡进度如何，预计什么时候能满产并贡献利润？ 答：投资者您好，根据公司 2026 年半年报披露的内容，公司湖北安陆生产基地多层板扩能项目已完成建设并投产，目前产能爬坡较快，符合公司预期。感谢您对公司的关注！ 2、（1）盈利能力与涨价传导：公司上半年订单金额同比增长 101.14%，订单数量增长 55.89%，Q2 订单均价环比 Q1 提升 21.77%，并表示调价效果将在下半年更加充分体现。请问目前新

价格订单已有多少比例确认收入？若覆铜板、铜箔、金盐等原材料价格维持当前水平，Q3、Q4 毛利率是否仍有继续环比改善空间？

（2）新增产能释放节奏：目前湖北新增 2.5 万平方米/月产能及清远 AI/算力产线的投产、爬坡和客户认证进度分别如何？预计何时能够明显贡献收入和利润？当前限制新增产能快速释放的主要因素是设备爬坡、良率、客户认证还是订单结构？（3）AI/算力新业务进展：公司披露 AI 服务器连接器、边缘算力盒子、人形机器人一体化关节模组等产品已进入量产阶段，请问目前相关业务收入占比大致处于什么区间？未来一年收入增量更主要来自汽车 PCB 份额提升，还是 AI/算力新业务放量？当前 AI 相关业务进一步放量最大的瓶颈是什么？

答：投资者您好，公司今年以来毛利率呈现逐季改善的趋势，第三和第四季度实际的毛利率情况请关注公司后续披露的定期报告。公司湖北安陆生产基地多层板扩能项目已完成建设并投产，目前来看，产能爬坡较快，符合公司预期，有助于缓解公司目前面临的产能瓶颈，更好满足现有客户对产量和交期的诉求。公司在算力基础设施、人形机器人等新兴产业应用领域积极推进产品研发和市场拓展工作，但尚处于起步阶段，相关应用领域产品营收占比较低且对公司业绩未构成重大影响。关于公司后续收入增量来源及订单结构请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的提问。

3、上半年承接订单金额同比增长 101%，Q2 产能利用率已接近满产，能否展望一下下半年收入增速的趋势？

答：尊敬的投资者您好，公司承接订单后，需要备料、生产、交付后方可确认收入（部分寄售客户需客户领用物料对账后确认收入），因此收入确认较订单承接具有滞后性，2026 年下半年的具体收入情况请关注公司后续披露的定期报告。谢谢！

4、请问，公司清远项目三季度投产的时间节点。

答：尊敬的投资者您好，公司已在 2026 年半年报中披露：根据目前实际建设情况，广东清远生产基地 PCB 扩建项目首条适配

AI 和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产。感谢您的关注与支持！

5、清远首条 AI 算力产线 Q3 即将投产，目前算力领域客户的导入验证进展如何？是否已有明确的意向订单？

答：投资者您好，根据公司 2026 年半年报披露的内容，公司 AI 服务器二次电源领域的 16 层 2 阶 HDI 厚铜电路板产品已试制成功并交客户验证；应用于人形机器人一体化关节模组、AI 数据中心 UPS、AI 服务器连接器、边缘算力盒子等领域的 PCB 已由试制转为量产。公司将结合新产线的投产安排，加快推进相关领域的客户拓展、产品验证、工厂审核、订单承接等工作。感谢您的提问！

6、商业航天概念很吸引人，但子公司还在亏损，这块业务大概什么时候能盈亏平衡、真正贡献利润？

答：尊敬的投资者您好，根据公司 2026 年半年报披露的内容，从事该应用领域 PCB 业务的子公司因营收规模较小，尚未达到盈亏平衡点，但其营业收入同比实现快速增长，单月的亏损呈现收窄态势，公司对其扭亏为盈持乐观态度，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注与支持！

7、东南亚 PCB 产能预计下半年集中释放，公司在新能源汽车 BMS 等核心领域的竞争优势，能否支撑市场份额持续提升？

答：感谢您对公司的关注及提问。公司密切关注包括东南亚 PCB 产能以及国内面向 AI 和算力的高端产能的建设及释放情况，围绕公司发展战略及年度经营计划积极开展相关工作，不断巩固自身核心竞争力。具体业绩情况请关注公司后续披露的定期报告。

8、公司 PCB 毛利率长期低于部分可比同行，请问核心原因究竟是什么？目前公司产能利用率已明显提升，随着高多层、HDI 及 AI 算力产品放量，公司预计毛利率能否持续提升、与同行差距能否明显收窄？其中 AI/算力类产品毛利率是否显著高于公司现有平均水平？

答：投资者您好，公司此前在年度报告中持续披露：受 PCB

	行业供大于求、行业内卷及“价格战”、产品主要应用领域所在的汽车产业链持续降价等影响，公司毛利率在过去几年中持续承压。今年以来，公司毛利率已呈现逐季改善的趋势，其中已承接的 AI/算力类量产产品的毛利率总体上高于公司汽车 PCB 产品的毛利率。感谢您的提问！ 9、关节模组 PCB 已量产，主要客户是谁？ 答：尊敬的投资者您好，基于商业政策，公司暂不便于披露该应用领域的客户名称。后续如有该应用领域可进一步披露的信息，公司将在定期报告中予以披露。感谢您的理解与支持！ 10、高频高速、高阶 HDI 等核心技术方向目前的突破进展如何？ 答：投资者您好，关于相关领域的技术进展将视实际情况在后续的定期报告中予以披露，感谢您的理解与支持！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 18 日